DDR6-память может появиться на рынке уже в 2027 году — над новым стандартом активно работают крупнейшие производители, включая Samsung, Micron и SK Hynix.

Спецификации были окончательно утверждены JEDEC ещё в 2024 году, а теперь начинается этап тестирования платформ и модулей.

Первыми новинку получат серверные и HPC-системы (высокопроизводительные вычисления), а массовый рынок, как и в случае с DDR5, увидит её чуть позже.

DDR6 предлагает базовую скорость передачи данных на уровне 8800 MT/s, что на 83% выше по сравнению с DDR5 (4800 MT/s). Максимальные скорости обещают достигать 17 600 MT/s — почти вдвое быстрее самых быстрых DDR5-модулей.

Вместе с увеличением пропускной способности, DDR6 получит обновлённую архитектуру: вместо двух 32-битных каналов теперь используются четыре по 24 бита. Это обеспечит более стабильную и быструю работу при высокой плотности и низком сопротивлении.

Также DDR6 потребует нового слота — стандарт CAMM2 может стать обязательным, поскольку позволяет сохранить качество сигнала на экстремальных частотах.

Все права защищены